



主要特点

工作频段: 6–18 GHz

增益: 26 dB

P_{-1} : +30 dBm

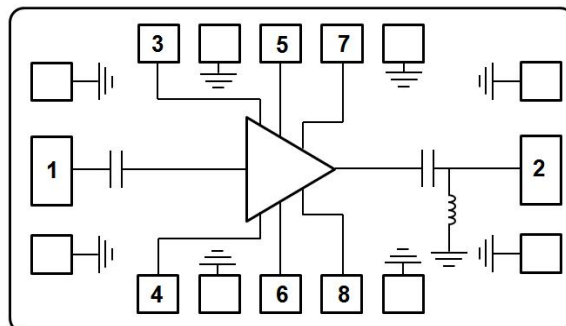
P_{sat} : +31 dBm

PAE: 27%

静态工作电流: 700 mA@+5 V

芯片尺寸: 3.0×2.4×0.1 mm³

功能框图

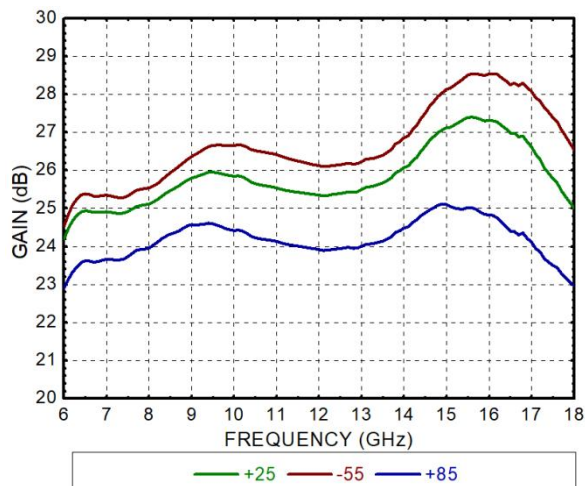


性能指标 ($T_A = +25^\circ\text{C}$, $V_D = +5\text{V}$, $V_G = -0.8\text{V}^*$, $I_{DQ} = 700\text{mA}$)

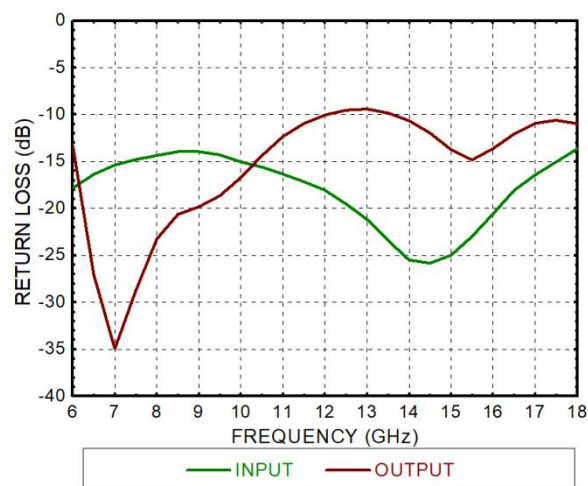
参数	最小	典型	最大	单位
工作频段	6 - 18			GHz
增益		26		dB
输入回波损耗		15		dB
输出回波损耗		12		dB
输出功率 1dB 压缩点		30		dBm
输出饱和功率@ $P_{in}=10\text{dBm}$		31	32.5	dBm
PAE	23	27	32	%
动态工作电流		1.0	1.4	A

* 可通过调节 V_G 来控制静态工作电流, V_G 可调范围为 -1V~ -0.7V.

增益vs. 温度

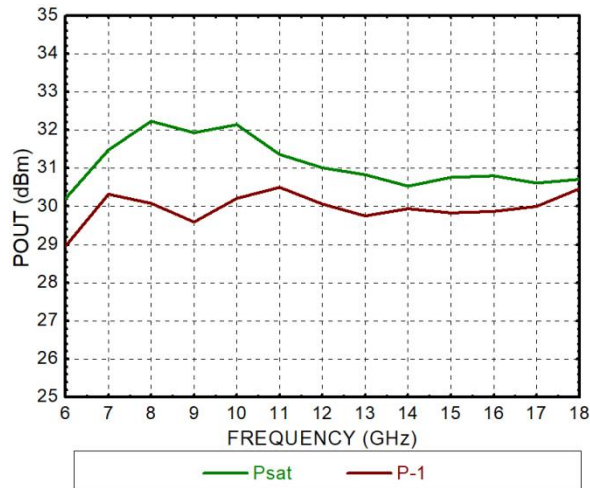


回波损耗

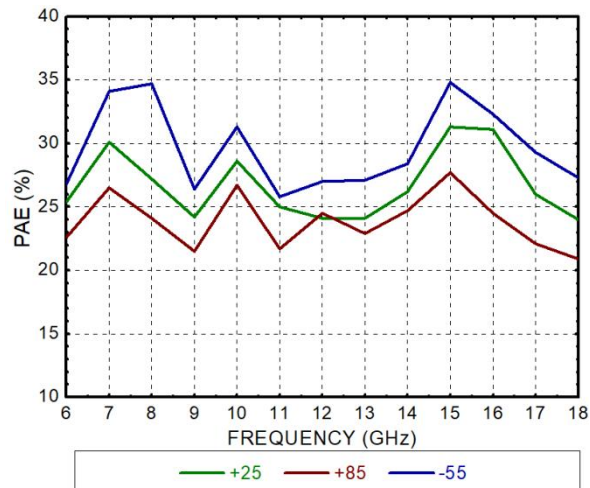




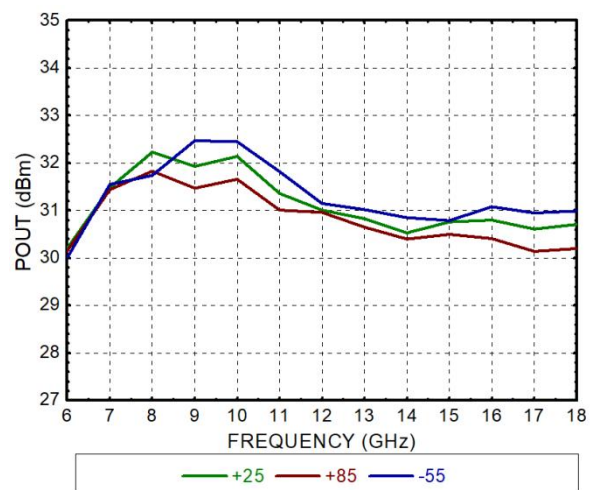
P_{-1} & P_{sat}



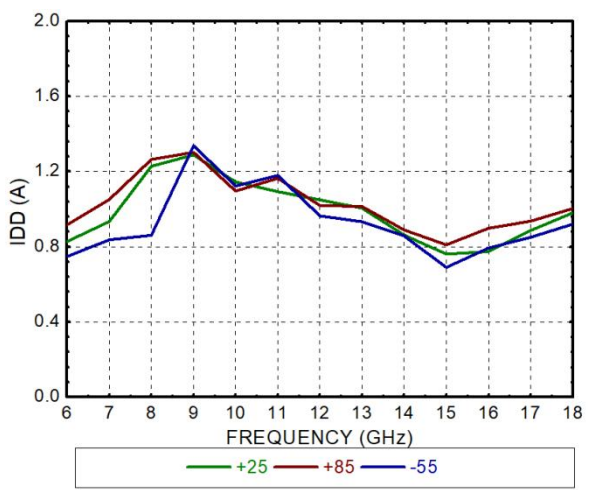
PAE vs. 温度



P_{sat} vs. 温度



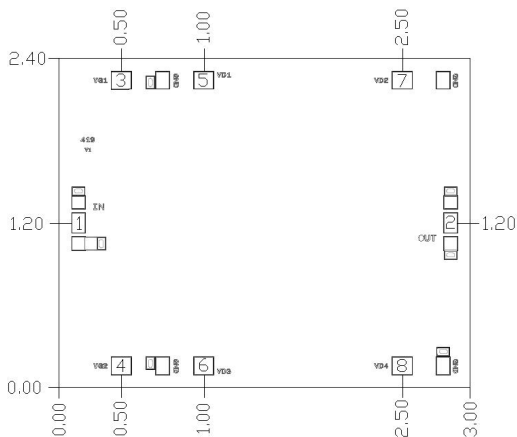
IDD vs. 温度





物理参数

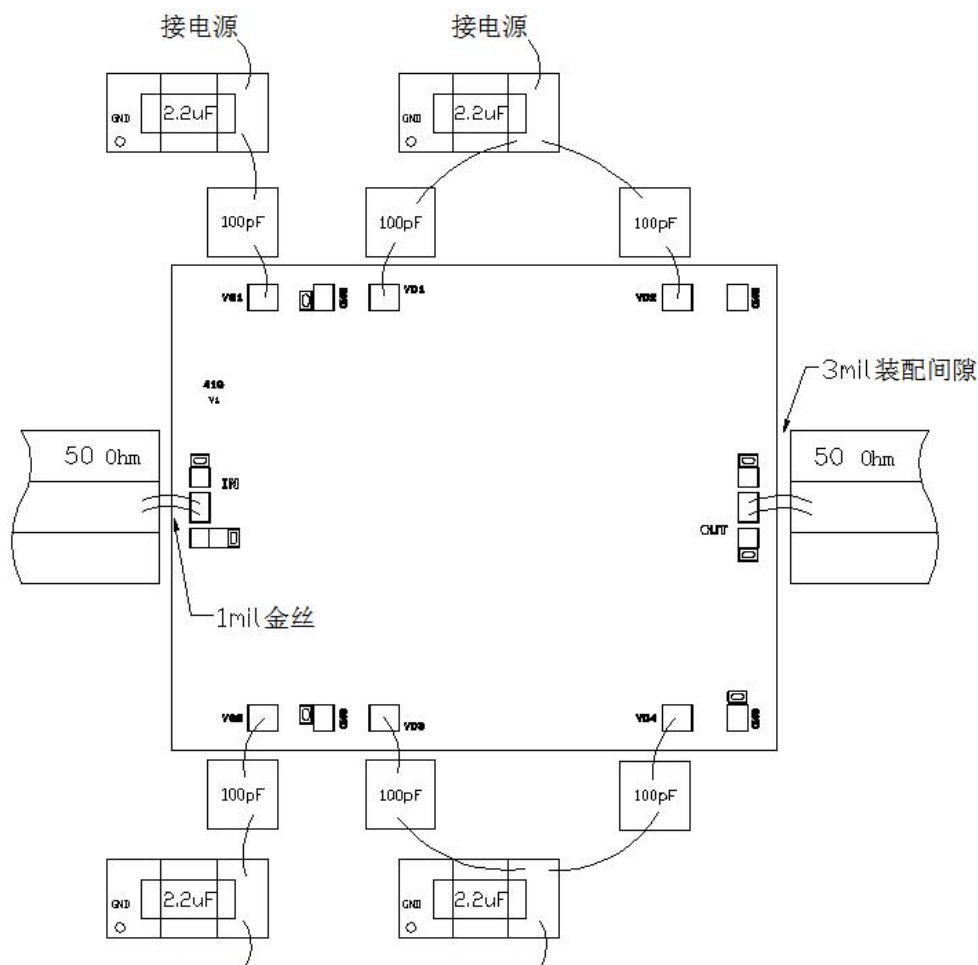
单位: mm



焊盘描述

焊盘序号	功能	描述
1	IN	该焊盘是 AC 耦合，片上集成了隔直电容，匹配至 50 Ohm
2	OUT	该焊盘是 DC 耦合，通过电感接地，匹配至 50 Ohm
3~4	VG	负电源电压，推荐使用-0.8V
5~8	VD	正电源电压，+5V
芯片背面	GND	芯片背面必须连接至 RF/DC 地

装配图



注意事项

1. 2.2uF 电容需尽量靠近芯片，以达到最佳的去耦效果
2. 可采用 AuSn 焊料共晶烧结或导电胶粘接工艺，安装表面必须清洁平整
3. 键合焊盘金属化：金
4. 芯片背面镀金
5. 芯片背面接地
6. 本产品采用空气桥工艺，表面不带钝化层

极限参数

1. 射频输入功率：+18dBm
2. 正电源电压：+6V
3. 负电源电压：-2V
4. 工作温度：-55~+85°C
5. 储存温度：-65~+150°C